

抛光粉/抛光液/抛光垫
研磨粉/研磨液/
研磨パッド/
⋮
その他の付属品



深圳市川研科技有限公司
Shenzhen Chuanyan Technology Co., Ltd.

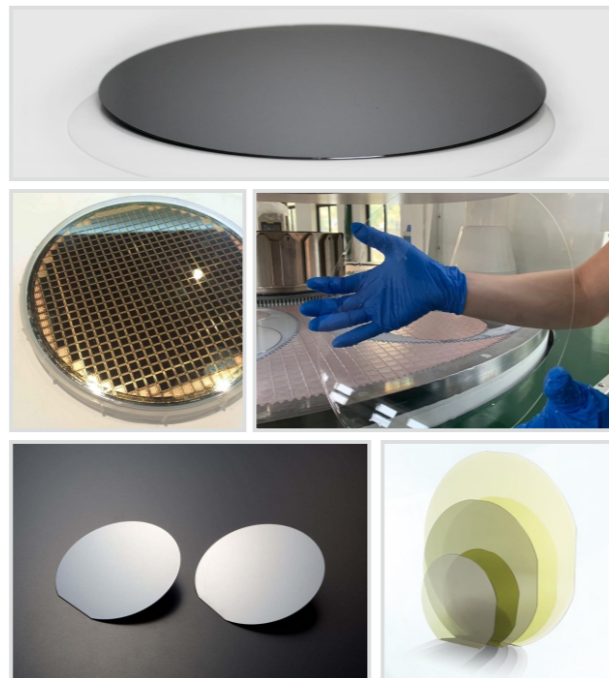
📍 深圳市龙岗区广达路68号贤达会展中心12层B ☎ 0755-2936 5755
🌐 www.sciyea.com ✉ tony@sciyea.com 📞 0755-2936 5535

企业简介

company profile

深圳市川研科技有限公司主要研发制造微米/纳米级稀土抛光粉、抛光液、聚氨酯抛光皮以及阻尼布。产品广泛应用于微电子领域、显示器工业以及化合物半导体、光学、光电、激光石英晶体等行业。与美国、日本、韩国和国内多家从事表面处理技术的研究院、公司、机构建立业务合作关系，可根据客户的需求提供不同的产品和技术支持。公司产品具有抛光效率高,使用寿命长,种类齐全,性能优良,使用范围广泛等优势,性价比与性能达到同行先进水平。

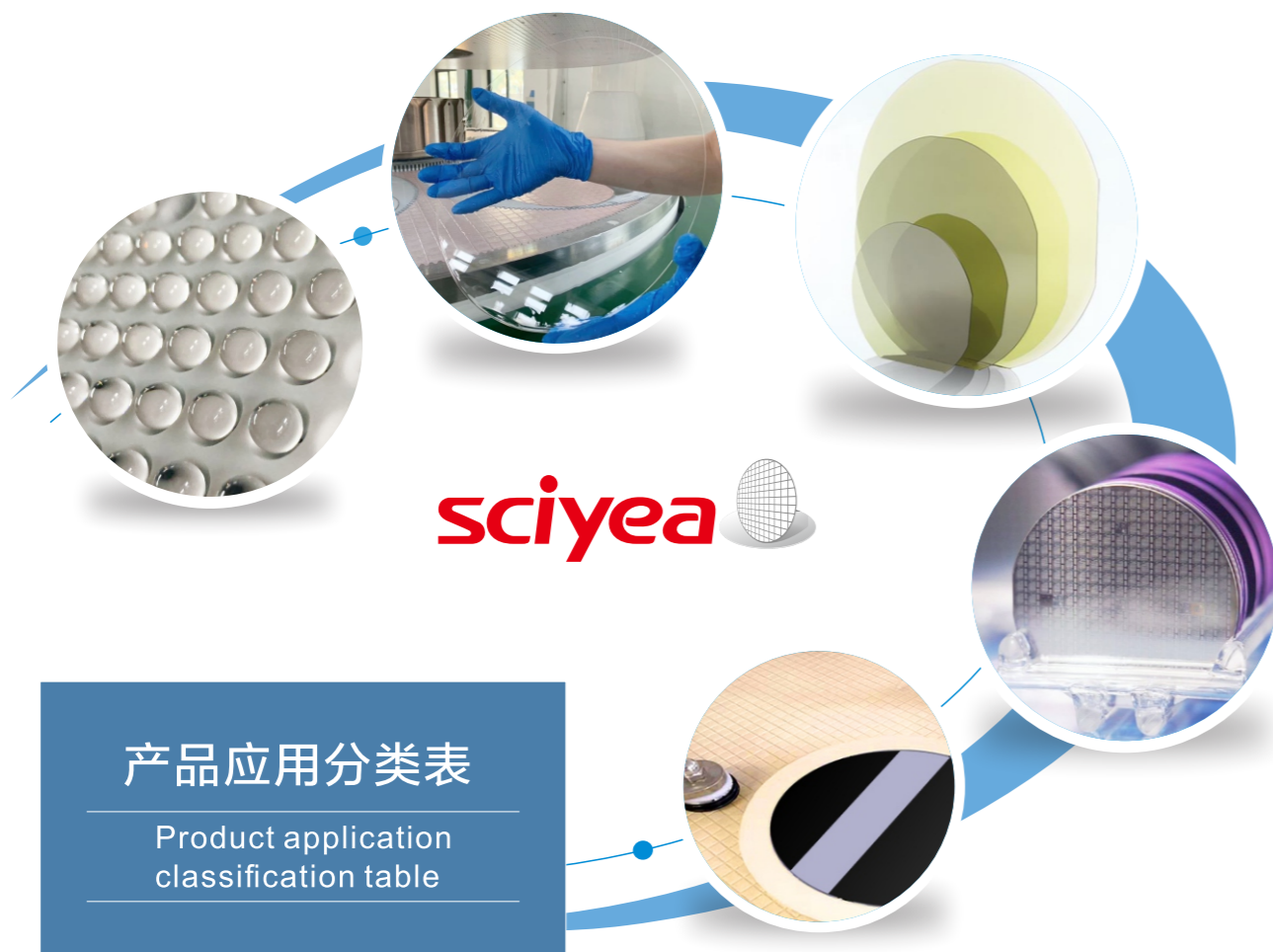
公司致力于产品质量的严格管控，已通过ISO9000、ISO14000的资格认证，并拥有完善的售后服务体系,以解决客户多方面相关需求。公司创办以来,一直遵循以人为本,关爱并致力于打造学习型员工为主，推行严谨、勤奋、专业、诚信的企业精神。以客户需求为中心,以员工为根本,用卓越的品质和利他的服务打造sciyea品牌而不懈努力。



CONTENS

目录 >>

公司简介	Page 01
产品应用分类表	Page 03
氧化铈抛光粉	Page 04
氧化铈抛光液	Page 05
氧化锆抛光液	Page 06
氧化铝抛光粉	Page 07
氧化铝抛光液	Page 08
二氧化硅抛光液	Page 09
聚氨酯抛光垫	Page 10
金刚石微粉	Page 11
金刚石研磨液	Page 12
碳化硅研磨粉	Page 13
COMPOL系列抛光液	Page 14
FUJIMI系列	Page 15
POLIPLA系列抛光液	Page 17
合成纤维抛光垫	Page 18
树脂研磨垫	Page 19
钻石研磨垫	Page 20
进口阻尼布	Page 21
阻尼布	Page 22



产品应用分类表

Product application classification table

行业	涉及产品
化合物半导体	合成纤维抛光垫、阻尼布、金刚石微粉/液、二氧化硅抛光液、氧化铝抛光液
精密光学玻璃	聚氨酯抛光垫、阻尼布、合成纤维抛光垫、金刚石研磨垫、氧化铈抛光粉/液、氧化锆抛光液
蓝宝石衬底、窗口片	合成纤维抛光垫、聚氨酯抛光垫、树脂研磨垫、金刚石研磨液、氧化铝抛光液
滤光片、蓝玻璃滤光片	阻尼布、氧化铈抛光粉/液、氧化锆抛光液、二氧化硅抛光液
光学晶体、激光晶体	聚氨酯抛光垫、阻尼布、氧化铈抛光粉/液、金刚石微粉/液、氧化铝抛光液
精密金属、钨钼合金	合成纤维抛光垫、阻尼布、金刚石微粉/液、二氧化硅抛光液、氧化铝抛光液
光通信	聚氨酯抛光垫、阻尼布、金刚石微粉/液、氧化铈抛光粉/液、二氧化硅抛光液
玻璃球（低熔点、高折射）	聚氨酯抛光垫、阻尼布、合成纤维抛光垫、金刚石微粉/液、氧化铈抛光粉/液
液晶面板、STN-LCD、TN-LCD、TFT-LCD	聚氨酯抛光垫、氧化铈抛光粉、吸附垫

氧化铈抛光粉

Cerium oxide polishing powder



产品说明

Sciyea系列氧化铈抛光粉为满足不同客户的需求，大致可分为以下多种型号。

产品特点

- 悬浮性好
- 切削力好
- 不易产生划伤
- 颗粒度均匀
- 稳定性好
- 易清洗
- 光洁度高
- 使用寿命长等优势



产品规格

型号	颜色	中心粒径 (um)	应用领域
1800	白色	0.6-0.8	精密光学、光纤（精度高）
1801	白色	0.7-1.0	晶圆、STN-LCD、TN-LCD、精密光学玻璃
1803	白色	1.0-1.3	蓝玻璃滤光片粗抛、ZF系列光学玻璃
1800E	白色	1.1-1.2	精密光学玻璃（均匀性高）
1804	白色	1.2-1.3	精密光学玻璃（精度高）
1805	白色	1.3-1.5	光学玻璃
1807	白色	1.8-2.0	光学玻璃（效率高）
1808	白色	1.8-2.3	TFT减薄、BK7、B270、K9、石英等光学玻璃
2800	红色	0.6-0.8	晶圆、光学玻璃
2801	红色	0.8-1.1	晶圆、磨耗度200-300光学玻璃
2803	红色	1.1-1.4	棱镜-多棱镜、光学玻璃
2805	红色	1.3-1.6	BK7、B270、K9光学玻璃
2806	红色	1.6-1.9	光学玻璃、石英玻璃、水晶
2808	红色	2.0-2.5	光学玻璃、石英玻璃
2809	红色	2.8-3.0	光学玻璃（效率高）

注：以上为产品标准规格，可根据客户不同需求提供不同粒径的产品。
包装规格：20kg/箱。

氧化铈抛光液

Cerium oxide slurry



氧化锆抛光液

Zirconia polishing slurry



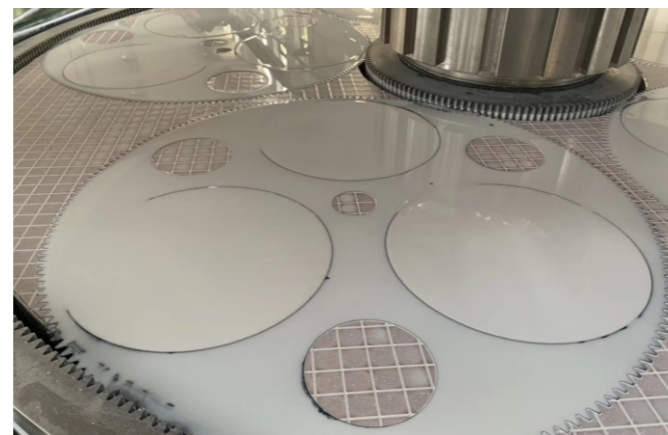
产品说明

Sciyea氧化铈抛光液采用严格的湿法微滤膜设备控制粒径，搭配进口化学增强抛光助剂，统筹抛光液的流变性能达到高效的抛光效率优质的抛光表面。

产品规格

型号	中心粒径 (um)	应用领域
SL800	0.2-0.4	蓝玻璃滤光片、晶圆
SL1000	0.1-0.2	玻璃晶圆、超精密玻璃
3802A	0.4-0.6	晶圆、精密光学玻璃精抛
3802B	0.3-0.5	超光滑、超精密玻璃
703B	0.9-1.1	光学玻璃、手机盖板玻璃
705B	1.5-1.8	光学玻璃、手机盖板、保护片玻璃

注：以上仅为产品标准规格，可根据客户需求提供不同粒径的产品。包装规格：5kg/瓶。



产品特点

- 适用于各种硬度的精密光学玻璃、蓝玻璃滤光片。
- 在保持高切削力的同时，能达到精密的抛光效果。
- 不易划伤
- 颗粒度均匀
- 稳定性高
- 悬浮性好
- 使用寿命长等优势

产品说明

Sciyea氧化锆抛光液具有抛光效率高、光洁度高、使用寿命长、悬浮性强、易清洁等特点，该产品主要解决抛光工艺中出现的镜片腐蚀现象（阿拉比、白点），可替代进口ZOX-N氧化锆抛光液。

产品规格

型号	中心粒径 (um)	固含量
3805S	1.0-1.3	25%-30%
3805	1.0-1.5	25%-30%
3808	1.2-1.6	25%-30%

注：以上仅为产品标准规格，可根据客户需求提供不同粒径的产品。包装规格：5kg/瓶。

应用领域

- 适用于软材质玻璃（磨耗度 > 350）
- 例如：FCD1、FCD505、FCD515、ZK9玻璃及红外滤光片、相机镜头、树脂镜片



氧化铝抛光粉

Alumina polishing powder



氧化铝抛光液

Alumina oxide slurry



产品说明

Sciyea氧化铝抛光粉，采用硅改性刚玉为主要原料。在严格控制粒径和改善粒子表面特性的基础上开发生产。在加工过程中，此聚集的结晶颗粒快速裂变和破碎，以达到提高切削力和表面质量的要求。

Sciyea标准粒度规格

粒度	粒度分布	
	中心粒径 (um)	包装 (KG)
#3000	4.00 ± 0.50	20
#4000	3.00 ± 0.40	20
#6000	2.00 ± 0.40	5
#8000	1.20 ± 0.30	5
#9000	0.71~0.90	5
#10000	0.51~0.70	5
#20000	0.50※(2)	5
#30000	0.32※1.3	5



产品规格

粒度	粒度分布		包装 (KG)
	中心粒径 (um)		
#240	58.6 ± 3.0		20
#280	49.4 ± 3.0		20
#320	41.4 ± 2.5		20
#360	36.1 ± 2.0		20
#400	30.9 ± 2.0		20
#500	26.4 ± 2.0		20
#600	21.1 ± 1.5		20
#700	17.9 ± 1.3		20
#800	14.7 ± 1.0		20
#1000	11.9 ± 1.0		20
#1200	9.90 ± 0.80		20
#1500	8.40 ± 0.60		20
#2000	6.90 ± 0.50		20
#2500	5.60 ± 0.50		20



产品说明

Sciyea氧化铝抛光液，采用硅改性刚玉为主要原料。在严格控制粒径和改善粒子表面特性的基础上开发生产。在加工过程中，此聚集的结晶颗粒快速裂变和破碎，以达到提高切削力和表面质量的要求。

产品特点

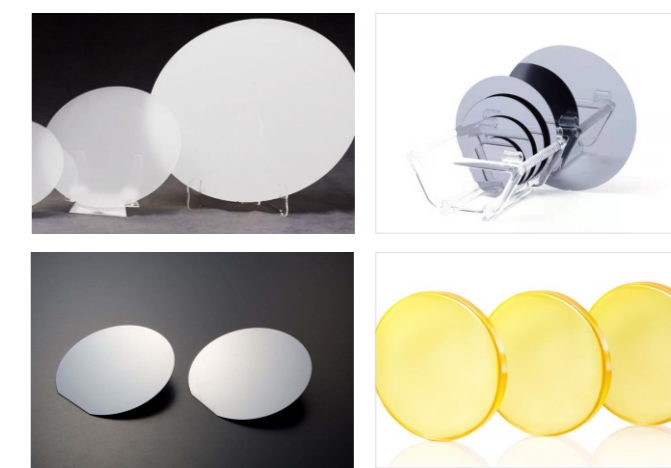
- 纯度高
- 可达纳米级范围
- 稳定性好
- 光洁度高
- 切削力好
- 颗粒度均匀
- 易清洗
- 使用寿命长等优势



产品规格

型号	PH值	中心粒径 (um)	应用领域
AI-1021	13.5	0.8	蓝宝石、锗片、晶体、陶瓷
AI-1088	13.5	1.2	蓝宝石衬底、半导体、金属
AI-1015	13.5	1.2	蓝宝石窗口、不锈钢、锗片
AI-1035	13.5	0.4	红外、合金、蓝宝石衬底
AI-801	1-3	< 0.1	碳化硅、氮化镓精抛
AI-802	1-3	< 0.4	碳化硅、氮化镓粗抛

注：可针对独特应用进行定制该产品。
包装规格：25kg/桶。



二氧化硅抛光液

Silica polishing slurry

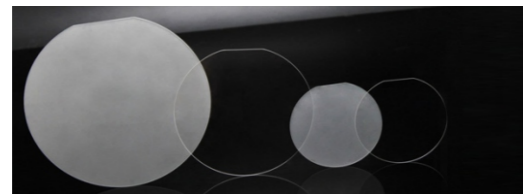


产品说明

Sciyea二氧化硅抛光液主要由高纯度的氧化硅微粉所组成。可避免加工时易产生的刮伤现象，适用于工件的精抛，能达到工件要求的镜面效果。

产品特点

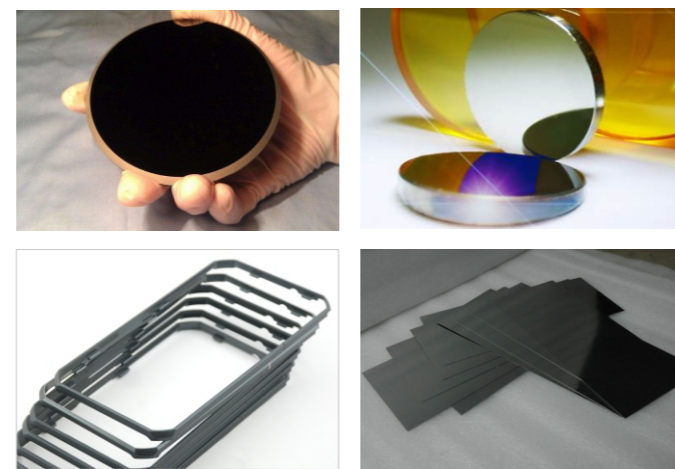
- 具备高纯度
- 抛光速率高
- 易清洗
- 粒度均匀



产品规格

型号	中心粒径(nm)	应用领域
3800	20-40	单晶硅、碳化硅、砷化镓、激光晶体等化合物半导体。
3801	60-80	蓝宝石衬底、激光晶体、光学晶体、铌酸锂、钽酸锂等。
3803S	60-80	氮化铝陶瓷
3803	80-120	激光晶体、精密金属、铝合金、氧化铝陶瓷。

注：以上为产品标准规格，可根据客户需求提供酸碱度及粒径不同的产品。



抛光垫

Polishing pad

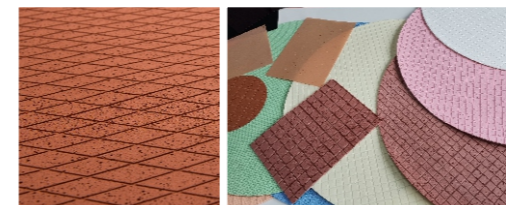


产品说明

Sciyea的FSP系列，由聚氨酯发泡制作而成。根据不同的研磨材料，分为氧化铈填充物、氧化锆填充物、氧化铝填充、以及不含磨料的纯聚氨酯抛光垫。有不同硬度可供选择，可背胶、可根据客户要求开槽。

产品特点

产品切效率高，被抛光产品表面无划伤，可使加工产品光圈更加稳定，使用寿命长，能替代LP66、GR35、LP26、LP57、SP66C等进口抛光垫。



产品型号

型号	硬度 (AskerC)	密度 (g/cm³)	填充物	应用领域
FSP66	80	0.42	CeO2	精密光学、晶圆、晶体
FSP66B	85	0.43	CeO2	精密光学、晶圆、LCD
FSP13	66	0.35	CeO2	精密光学、晶体、LCD
FSP35	90	0.59	ZrO2	陶瓷、精密金属、LCD
FSP26	88	0.57	ZrO2	玻璃、精密光学
FSP57	88	0.51	None	光学、石英、半导体基板
FSP20	92	0.58	None	蓝宝石窗口片

产品规格

圆形尺寸 (mm)	圆形尺寸 (mm)	方形尺寸 (mm)	应用领域
380	1180	590*1400	LCD/LED基板玻璃、光学玻璃、蓝宝石窗口、化合物半导体、手机玻璃、半导体基板/硅片(多晶硅、单晶硅)砷化镓、压电晶体、石英晶体、水晶玻璃、蓝玻璃滤光片、精密光学器件、金属及合金、硬盘、陶瓷材料等产品的高速抛光。
590	1340	650*1400	
640	1405	700*1400	
820	1500	840*1700	
960	-	1000*1000	
1050	-	1500*1500	
厚度范围 (mm)			
0.5~3.0			

金刚石微粉

Diamond powder



金刚石研磨液

Diamond slurry



产品说明

Sciyea金刚石微粉可分为：多晶金刚石微粉、单晶金刚石微粉、纳米金刚石微粉，原料采用高强度、高纯度的优质金刚石。适用不同的研抛过程和工件。产品分散性好、粒度均匀、规格齐全、质量稳定，能广泛用于硬质材料的研磨和抛光。

应用领域

半导体加工

单晶/多晶硅、碳化硅、氮化镓、蓝宝石衬底、蓝宝石窗口片等化合物半导体。

陶瓷材料加工

氧化锆指纹识别片、氧化锆陶瓷手机后壳、氮化铝陶瓷及其它功能陶瓷。

金属材料加工

不锈钢、铝合金、硬质合金、钨钼合金及其它金属材料。

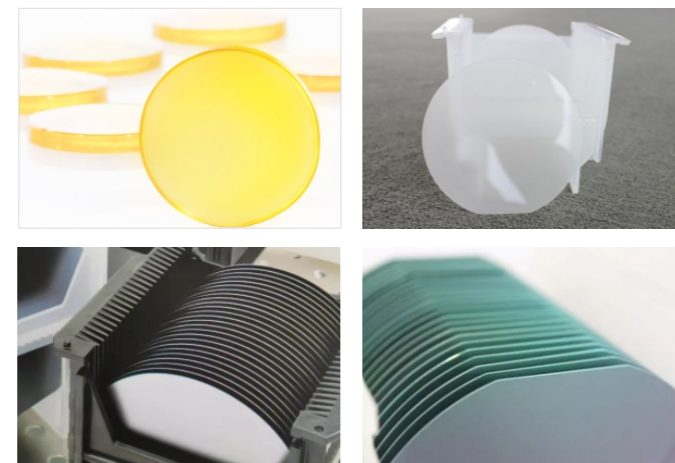
光学晶体

硒化锌晶体、硫化锌晶体及其它晶体材料。

产品规格

	多晶金刚石	多晶金刚石	单晶金刚石	单晶金刚石
D50 (um)	0.11-0.14	2.00-2.50	0.91-1.04	0.24-0.26
D50 (um)	0.20-0.25	2.70-3.10	0.75-0.90	0.17-0.18
D50 (um)	0.45-0.55	4.00-4.40	0.60-0.70	0.13-0.14
D50 (um)	0.60-0.78	5.30-5.80	0.45-0.55	0.04-0.06
D50 (um)	0.90-1.10	7.50-5.50		

	纳米金刚石			
粒度	30nm	50nm	100nm	未分级产品，一次粒径4-7nm



产品说明

Sciyea金刚石研磨液包括多晶、单晶、纳米三种不同类型的抛光液。由优质的金刚石微粉复合分散剂和分散介质组成，配方多样化，适用不同的研抛过程和工件。产品分散性好、粒度均匀、规格齐全、质量稳定，能广泛用于硬质材料的研磨和抛光。

应用领域

蓝宝石加工

用于蓝宝石A向、C向、R向、M向蓝宝石盖板、蓝宝石衬底片、蓝宝石窗口片。

半导体加工

单晶/多晶硅、碳化硅、氮化镓

陶瓷材料加工

氧化锆指纹识别片、氧化锆陶瓷手机后壳、氮化铝陶瓷及其它功能陶瓷。

光学晶体

硒化锌晶体、硫化锌晶体及其它晶体材料。

金属材料加工

不锈钢、铝合金、硬质合金、钨钼合金及其它金属材料。

应用领域

	多晶金刚石	多晶金刚石	类多晶金刚石	类多晶金刚石
D50 (um)	0.11-0.14	2.00-2.50	0.11-0.14	2.00-2.50
D50 (um)	0.20-0.25	2.70-3.10	0.20-0.25	2.70-3.10
D50 (um)	0.45-0.55	4.00-4.40	0.45-0.55	4.00-4.40
D50 (um)	0.60-0.78	5.30-5.80	0.60-0.78	5.30-5.80
D50 (um)	0.90-1.10	7.50-5.50	0.90-1.10	7.50-5.50

	纳米金刚石			
粒度	30nm	50nm	100nm	未分级产品，一次粒径4-7nm



碳化硅微粉

Silicon carbide powder



COMPOL系列抛光液

COMPOL series polishing fluid



产品说明

Sciyea系列研磨粉的主要成份为碳化硅,硬度仅次于金刚石的超硬研磨粉,中心粒径最细仅0.25微米,用于各式晶体切割以及硬质金属的研磨。

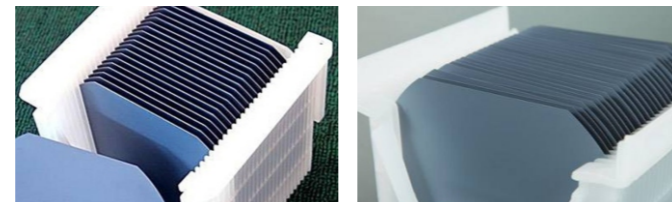
Sciyea标准粒度规格

粒度	粒度分布	
	中心粒径 (um)	包装 (KG)
#3000	4.00 ± 0.50	20
#4000	3.00 ± 0.40	20
#6000	2.00 ± 0.40	5
#8000	1.20 ± 0.30	5
#9000	0.71~0.90	5
#10000	0.51~0.70	5
#20000	0.50*(2)	5
#30000	0.32*1.3	5



产品规格

粒度	粒度分布		包装 (KG)
	中心粒径 (um)		
#240	58.6 ± 3.0		20
#280	49.4 ± 3.0		20
#320	41.4 ± 2.5		20
#360	36.1 ± 2.0		20
#400	30.9 ± 2.0		20
#500	26.4 ± 2.0		20
#600	21.1 ± 1.5		20
#700	17.9 ± 1.3		20
#800	14.7 ± 1.0		20
#1000	11.9 ± 1.0		20
#1200	9.90 ± 0.80		20
#1500	8.40 ± 0.60		20
#2000	6.90 ± 0.50		20
#2500	5.60 ± 0.50		20



产品说明

主要由高纯度的胶态氧化硅微粒所组成,可避免加工元件产生刮伤的现象。特别适用于钽酸锂、钽酸锂、蓝宝石、石英等电子材料,光学晶体、金属等抛光。

产品规格

Type	SiO2含量(%)	PH	比重	平均粒径(nm)	包装(20KG)
20	40	9.2	1.30	15.0	20
50	40	10.2	1.30	40.0	20
80	40	10.2	1.30	72.0	20
120	40	9.2	1.30	82.5	20
EX-3	30	9.5	1.385	32.5	20
505	40	9.4	1.29	34.6	20





WA氧化铝微粉

WA系列研磨微粉是高纯度的氧化铝微粉,在严格的粒度分布控制下,共分为21个粒径等级,中心粒径由57微米到0.3微米。WA系列产品普遍运用于光电产品与金属材料元件。

WA品质规格

Type	粒度	比重	粒度分布				
			Ai2O3	SiO2	Fe2O3	TiO2	ZrO2
A	#240~#1200	≥3.85	≥90.00	≤5.00	≤0.80	≤5.00	----
	#1500~#4000	≥3.75	≥80.00	≤18.00	≤1.00	≤3.00	----
WA	#240~#3000	≥3.90	≥99.00	≤0.30	≤0.10	----	≤0.50
	#4000~#10000	≥3.85	≥96.00	≤1.20	≤1.20	----	≤0.70
	#20000~#30000	≥3.60	≥96.00	≤1.30	≤1.20	----	≤0.70

WA标准粒度规格

粒度	粒度分布		包装		粒度	粒度分布		包装		粒度	粒度分布		包装		
	累积高50% 粒子径	(KG)	累积高50% 粒子径	(KG)		累积高50% 粒子径	(KG)	累积高50% 粒子径	(KG)		累积高50% 粒子径	(KG)	累积高50% 粒子径	(KG)	
#240	58.6±3.0	5	5	#700	17.9±1.3	4	4	#3000	4.00±0.50	4	3	#240	58.6±3.0	5	5
#280	49.4±3.0	5	5	#800	14.7±1.0	4	4	#4000	3.00±0.40	4	3	#320	41.4±2.5	5	5
#320	41.4±2.5	5	5	#1000	11.9±1.0	4	4	#6000	2.00±0.40		3	#360	36.1±2.0	5	5
#360	36.1±2.0	5	5	#1200	9.90±0.80	4	4	#8000	1.20±0.30		2	#400	30.9±2.0	5	5
#400	30.9±2.0	5	5	#1500	8.40±0.60	4	4	#10000	0.50~0.70		2	#500	26.4±2.0	5	5
#500	26.4±2.0	5	5	#2000	6.90±0.50	4	4	#20000	0.40~0.50		2	#600	21.1±1.5	5	5
#600	21.1±1.5	5	5	#2500	5.60±0.50	4	3	#30000	0.30~0.39		2				

FO光学微粉

FO系列研磨粉以氧化铝、氧化硅、氧化锆等数种磨料依特殊的比例所配制,具有高韧性的特性,可有效避免加工元件中所产生的刮伤。该系列产品广泛应用于半导体材料及各类晶体元件。

FO光学微粉粒度规格

种类	FO		
粒度	#240~ #400	#500~ #1200	#1500~ #4000
比重	3.90	3.90	3.90
粒度分布	Ai2O3	45.0	45.0
	SiO2	20.0	20.0
	Fe2O3	0.5	0.5
	TiO2	2.0	2.0
	ZrO2	38.0	38.0

GLANZOX系列抛光液

GLANZOX系列抛光液是专用于硅晶片的抛光液,随着近年来研发硅元件电路的发展,对硅晶片面精度的要求已越来越严格。而GLANZOX系列产品正是针对硅晶片抛光所研发出来的产品。

产品规格

粒度	累积高50%粒子径	包装
#240	40.0±3.0	5
#280	34.0±2.5	5
#320	28±2.3	5
#400	23.0±2.1	5
#500	19.0±1.6	5
#600	16.0±1.3	5
#700	13.5±1.1	4
#800	11.3±0.9	4
#1000	9.4±0.8	4
#1200	7.1±0.7	10
#1500	5.5±0.5	4
#2000	4.5±0.4	4
#3000	3.6±0.4	3
#4000	2.7±0.4	3

POLIPLA系列抛光液

POLIPLA series polishing fluid

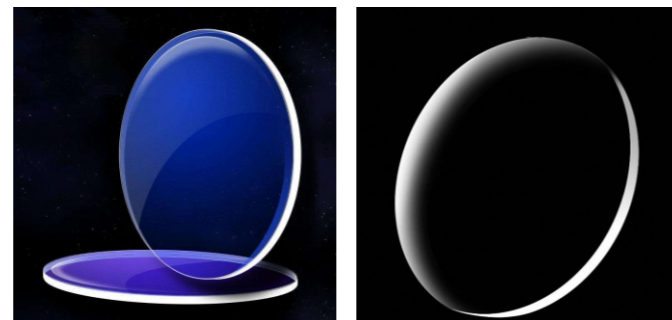


产品说明

POLIPLA系列抛光液为一种复合型的抛光液,适用于树脂晶片、金属的抛光,其中磨料比例与硬度的适当配合,大大提高抛光的时间,可以完全保障镜片、金属表面的高度光洁。

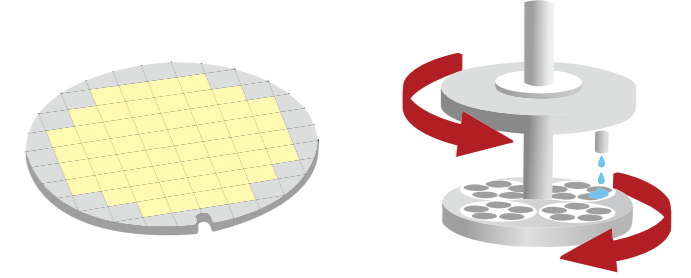
产品规格

Type	PH	平均粒径	比重	研磨效率	面精度
103	3.5	1.30	1.160	0.11	24
308A	3.4	1.40	1.165	0.16	24
608S	3.5	1.30	1.115	0.12	25
203H	3.4	0.85	1.162	0.07	23
203Z	3.4	1.30	1.165	0.12	24
304M	3.4	2.80	1.184	0.13	24



合成纤维抛光垫

Synthetic paper polishing pad



产品说明

Sciyea系列产品中合成纤维抛光垫主要用于半导体晶片的粗抛和中抛,同时也可以用于硅片、砷化镓、磷化铟、碳化硅、氮化铝陶瓷、钽酸锂、铌酸锂、蓝宝石衬底的抛光,具有抛光速率高、表面质量好等特点。

产品规格

型号	KV66	KV66	KV66	BMP80	BMP90
厚度 (mm)	1.13	1.35	1.50	1.30	1.50
密度 (g/m ²)	420	560	620	470	510
硬度 (Asker C)	78	82	85	91	85
压缩率 (%)	58	50	90	63	68

产品特点

Sciyea合成纤维系列抛光垫可以根据客户的工艺要求进行开槽,以此来增加抛光液的流动性,提升抛光效率和抛光精度,可取代SUBA系列产品。



树脂研磨垫

Resin Grinding Pad



产品说明

Sciyea树脂研磨垫的型号为YMD07。采用进口树脂，常规搭配金刚石研磨液使用，树脂研磨垫有着去除率高，寿命长，平整度高的特点，用于磨削蓝宝石盖板、蓝宝石窗口片、陶瓷片等精磨工序，能替代树脂铜盘，碳化硼/金刚砂工艺，减少研磨发生的破坏层，大幅缩短抛光时长。

产品规格

型号	厚度 (mm)	硬度	TTV	使用寿命
YMD07	2.00	92	< 4um	450-650h

注：可针对独特应用进行定制该产品尺寸及性能。

产品特点

- 用于蓝宝石衬底片，蓝宝石窗口片、A向、C向。
- 降低成本，能够替代树脂铜盘，树脂铁盘，减少抛光前的划伤处理。
- 切削力强
- 研磨效果佳
- 寿命长
- 性能稳定



钻石研磨垫

Diamond grinding pad



产品说明

Sciyea钻石研磨垫，无需混合浆料，节省研抛时间并改善了车间环境，大幅降低无泥浆处理成本、环境清洁费用，研磨垫通过背胶与研磨盘粘贴，以实现便捷的安装和拆卸，金刚石研磨垫可直接安装到现有研磨盘/抛光盘上。

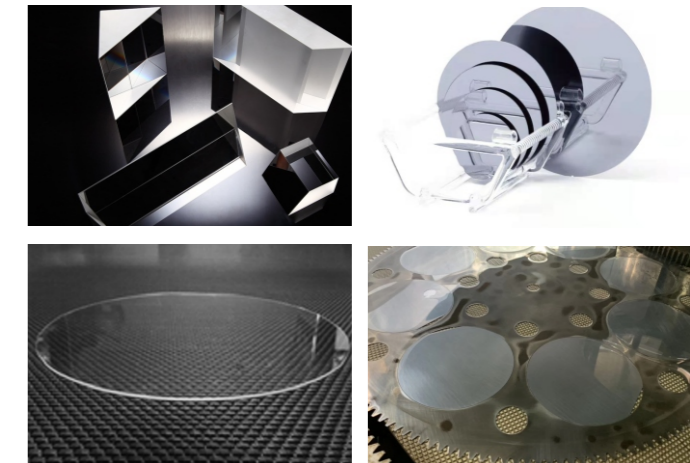
产品规格

型号	厚度 (mm)	粒径 (um)	TTV	使用寿命
Y001-4	2.60	4	< 5um	250-380h
YF01-9	2.20	9	< 4um	210-350h
Y001-4	2.60	4	< 5um	250-380h
YF01-9	2.20	9	< 4um	210-350h

注：可针对独特应用进行定制该产品外观/粒径等性能。

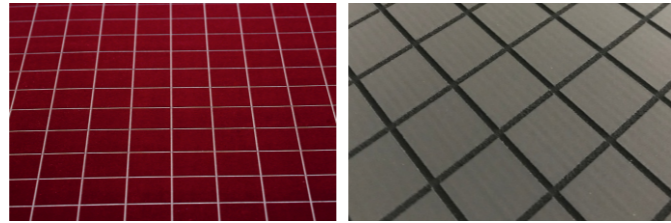
产品特点

- 用于研磨光学玻璃，玻璃晶圆，棱镜，红外，陶瓷等材质。
- 降低成本，能够替代研磨粉，铸铁盘/铜盘，并减少抛光前的划伤。
- 获得更好的粗糙度
- 速率高
- 寿命长
- 洁净、环保



进口阻尼布

Polishing Pad



产品特点

千代田、丸石阻尼布，广泛应用于蓝玻璃滤光片、半导体、光学玻璃的研磨抛光，产品具有速率快、良率高、使用寿命长等多方面优势。

应用领域

半导体加工

单晶/多晶硅、碳化硅、氮化镓、蓝宝石衬底、蓝宝石窗口片等化合物半导体。

陶瓷材料加工

氧化锆指纹识别片、氧化锆陶瓷手机后壳、氮化铝陶瓷及其它功能陶瓷。

金属材料加工

不锈钢、铝合金、硬质合金、钨钼合金及其它金属材料。

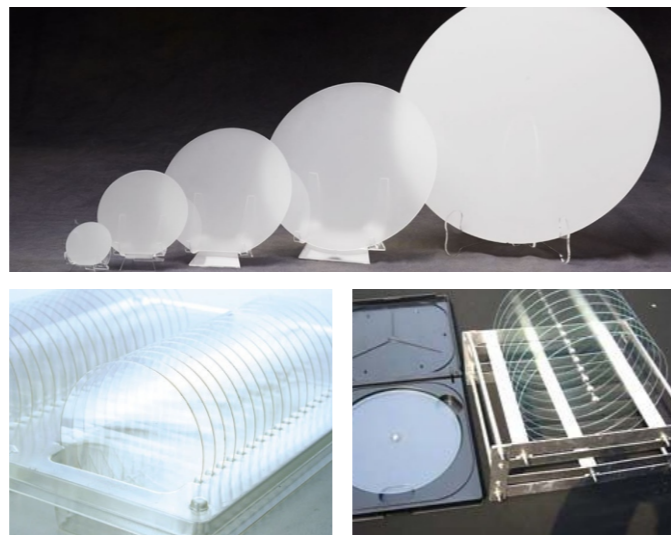
光学晶体

硒化锌晶体、硫化锌晶体及其它晶体材料。

产品规格

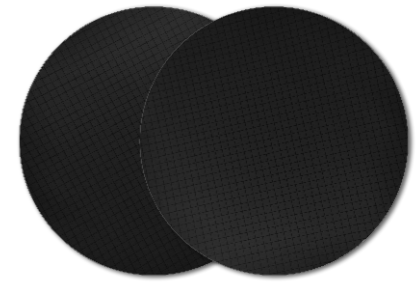
型号	厚度 (mm)	密度 (g/cm ³)	压缩比 (%)	硬度 (AskerC)
1900w	0.95	0.37	4.5	67
KS1200	0.81	0.34	7.2	60
KS1300	0.92	0.35	4.0	64
KS7355	1.49	0.35	3.3	58

注：可根据客户需求提供开槽、压槽、背胶工艺。



阻尼布

Polishing Pad



产品特点

Sciyea阻尼布采用各种优质细腻的基材，通过干燥、凝固等数十种复杂工艺才得以制成。此布主要应用于产品的精加工，以满足产品表面高光洁度、高平滑性的要求。

应用领域

广泛应用于蓝玻璃滤光片、半导体、精密光学玻璃、红外晶体、蓝宝石、玻璃晶圆、陶瓷基板的最终抛光。

产品规格

型号	厚度 (mm)	密度 (g/cm ³)	硬度 (AskerC)	压缩比 (%)	应用领域
NS841	1.50	0.35	58	3.0	陶瓷、Si、Sic、等化合物半导体
NS3200	1.50	0.36	58	2.9	AlN、Sic、Gap等化合物半导体
NS3210	1.80	0.45	56	3.6	GaAS、Sic、Gap等化合物半导体
NS9410	1.00	0.46	64	4.1	精密光学、玻璃球

注：可根据客户需求提供开槽、压槽、背胶工艺。

